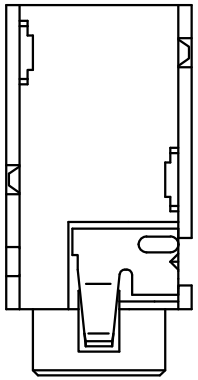
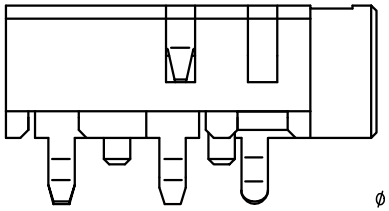


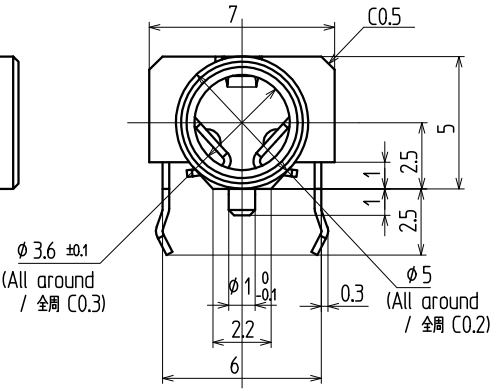
Notes / 注記

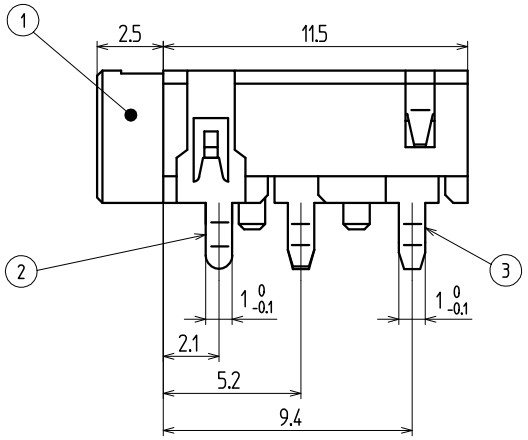
1.In case use P.C board of through holes, don't prepare a land in part side.
スルーホール基板を使用する際は、部品面側にランドを設けない事。

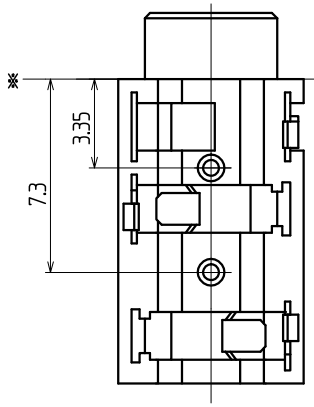
2.Take care not to let the solder flow into the part of A when you solder a jack with a soldering iron.
半田ゴテにて半田付けする場合は、A部に半田が流れ込まない様に注意して下さい。

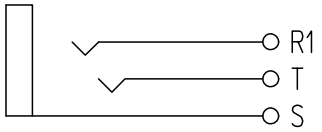
3.When soldering in auto soldering bath, it is suggested to check contact failure, appearance failuer etc, by flux before.
自動半田槽にて半田付けを行う際には、事前にフラックス流入による接触不良、外観不良等の確認をお願いします。



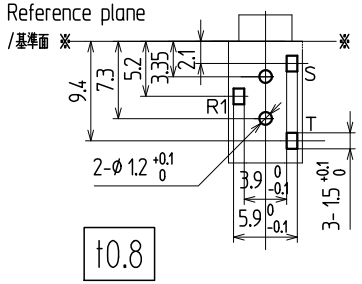


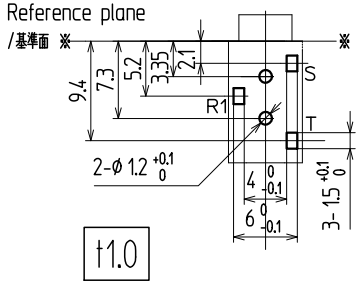


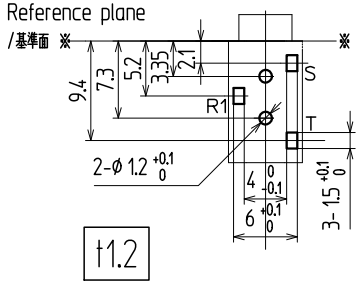




Circuit / 回路図







Note / 注1

Referential dimensions of PC board holes / 参考基板孔寸法図

(Printed-side view/パターン面)(Tolerance/公差 ALL±0.1) (S=2/1)

No. 品番	PARTS NAME 名称	Q'TY 個数	MATERIAL 材質		No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
3	CONTACT コンタクト	2	PHOSPHOR BRONZE りん青銅 0.25	(T,R1)			SILVER PLATED Agめっき	
2	EARTH CONTACT アースバネ	1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅 0.25	(S)			SILVER PLATED Agめっき	
1	HOUSING ハウジング	1	PA66 G15% BLACK 黒			94V-0		

3.5 DIA LA4

TOLERANCE 寸法公差		MARK 記号	REVISIONS 改訂事項	DATE 日付	SIGN 担当
6 under 未満	± 0.3	X			
over 以上 6 under 未満 20	± 0.4	X			
over 以上 20 under 未満	± 0.5	X			
over 以上	±	X			
ANGLE(DEG) 角度	± 5°				

ALL DIMENSIONS IN ( ) ARE FOR REFERENCES ONLY
( ) 印は、参考寸法

APPROVED 責任者	CHECKED 照査者	DRAWN 製図者	DESIGNED 設計者

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.

Ⓐ承 · P製

UNIT 単位 mm

SCALE 尺度 5/1

TITLE 名称 **3.5 DIA PHONE JACK / 小形単頭ジャック**

CODE No. コードNo. **YKB21-5274B**

DRAWING No. 図番 ▫

PAGE ページ ▫ — REVISION 版数 ▫

CUSTOMER CODE ユーザーコード ▫

ISSUED 出図

RB9501BA03-00